

红胶工艺是一种聚稀化合物，与锡膏不一样的是其遇热之后便干固，其凝点环境温度为150℃，这个时候，红胶慢慢由泥状体立刻变为固体状态。

红胶具有粘度流动性，环境温度特性，润湿特性等。按照红胶的这一特点，因而在生产加工制造中，应用红胶的动机就是使零配件牢固地黏贴于PCB表面层，防止其脱落。当红胶工艺技术情况下，需要把双波峰焊开全，才能够实现红胶引锡的问题和焊点圆润缺点少。

厚网红胶加工工艺中，波峰焊掉件，一般跟胶量不足和误差有关。厚网通孔的完好性和流畅性都是会影响红胶通过通孔而漏胶多与少，如此一来进而影响漏胶量的大小。一般，厚网通孔的完整和顺畅，又和厚网的清洗息息相关，红胶厚网的清洗是市场里边数年堆积出来的老大难问题，也是个很难完全彻底解决问题，钢网清洗机配上水基清洗剂能够完整地、不需要什么人力协助，将红胶厚网完全彻底冲洗干净，而确保红胶厚网的完好性。系统化实现了在红胶厚网加工工艺中波峰焊掉件漏件的情况。进而提升这种生产线的一次性成功率和工序质量。